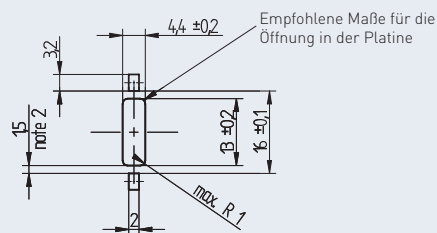


Anmerkung / note 1: Die maximale Paketdicke von Platine und Kühlkörper sollte 3.6 mm nicht überschreiten.

Generelle Empfehlung: Die beiden Lötflächen eines Klemmpoles auf der Platine sollten elektrisch miteinander verbunden werden



Anmerkung / note 2: Die einzuhaltenden Luft- und Kriechstrecken müssen abhängig von der Anwendung berücksichtigt werden.

SMD-Leiterplatten-Durchsteckklemme mit Steckkontakten

1-polig - 46.111.1001-0

Direktes Stecken von eindrätigen und feindrätig, verzinnten Leitern

Leiter durch gleichzeitiges Drehen und Ziehen lösbar

Montage- und Verdrahtungsposition: Leiterplatte unterseitig

Vorschaltgerät und Leiterplattenklemme auf einer Ebene

Automatengerechte "Tape-and-Reel" Verpackung

Befestigung: Bleifreie Reflow-Lötung nach DIN EN 610760-1, Abschnitt 6

Material: Gehäuse: PPA, weiß
Kontaktwerkstoff: CuNiSiP
Kontaktoberfläche: feuerverzinkt

Daten zur Verpackung 46.111.1001-0	
Gewicht SMD-Klemme	0.5 g
Anzahl Klemmen pro Spule	950 Stück
Durchmesser der Spule	381 mm - 15"
Gewicht pro Spule	1.08 kg
Anzahl an Spulen pro Karton	10 Stück
Anzahl an SMD-Leiterplatten-klemmen pro Karton	9.500 Stück
Gewicht pro Karton	9.12 kg
Abmessungen Karton (LxBxH)	400 x 405 x 415 mm

Anschlussdaten	
Anschlusstechnik	Steckkontakt
Eindrähtige Leiter	0.2 - 0.75 mm ² , AWG 24-18
Feindrähtige, verzinnte Leiter	0.2 - 0.5 mm ² , AWG 24-20
Abisolierlänge	8 +1 mm
Leitereinführung	0 - 10°
Leiterlösefunktion mittels	Drehen und Ziehen

Auszugskraft nach DN 60999-1

0.2 mm ²	min. 10 N
0.34 mm ²	min. 15 N
0.5 mm ²	min. 20 N
0.75 mm ²	min. 30 N
Einsteckkraft	max. 10 N

Geometrische Daten

Rastermaß	4 mm / 0.157 inch
Breite	3.95 mm / 0.155 inch
Höhe	7.5 mm / 0.295 inch
Tiefe	21.7 mm / 0.85 inch

Werkstoffdaten

Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff	PPA, weiß
PTI	600
Entflammbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Kontaktwerkstoff	CuNiSiP
Kontaktoberfläche	feuerverzinkt

Mechanische Daten

Montageposition	Leiterplatte unterseitig
Befestigungsart	Bleifreies Reflow-Löten

Temperaturbedingungen

Grenztemperaturbereich	-70 °C bis + 150 °C
Umgebungstemperatur	-70 °C bis + 120 °C
T-Klassifizierung nach IEC 60998-1 Abs. 12	120° C

Bemessungsdaten gemäß IEC / EN 60947-7-4 (IEC/EN 60664-1) für Leiterplattentyp FR4 1.0 mm

Bemessungsspannung (III / 3)	200 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	2.5 kV
Bemessungsspannung (III / 2)	250 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	2.5 kV
Bemessungsspannung (II / 2)	400 V
Bemessungsstoßspannung (II / 2)	2.5 kV
Bemessungsstrom	9 A

Bemessungsdaten gemäß IEC / EN 60947-7-4 (IEC/EN 60664-1) für Leiterplattentyp IMS

Bemessungsspannung (III / 3)	63 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	2.5 kV
Bemessungsspannung (III / 2)	160 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	2.5 kV
Bemessungsspannung (II / 2)	320 V
Bemessungsstoßspannung (II / 2)	2.5 kV
Bemessungsstrom	9 A

Bemessungsdaten gemäß UL 1777 / CSA-C22.2 No. 182.3

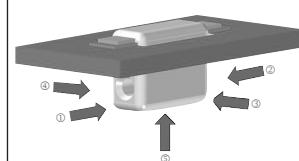
Bemessungsspannung	600 V
Bemessungsstrom	USR 9 A, AWG 24 -18 CNR 6 A, AWG 24-20 CNR 9 A, AWG 18

Länderspezifische Zulassungen Zertifikate

VDE / ENEC	EN IEC 60947-7-4 Ausweis-Nr.: 40040866
cURus	UL 1777 / CSA-C22.2 No. 182.3, File no.: E-365006

Scherkräfte nach IEC 62137-1-2.

Bei diesen Werten handelt es sich um Maximumwerte, die nur für eine kurzzeitige Belastung gelten, nicht für Dauerbelastung.

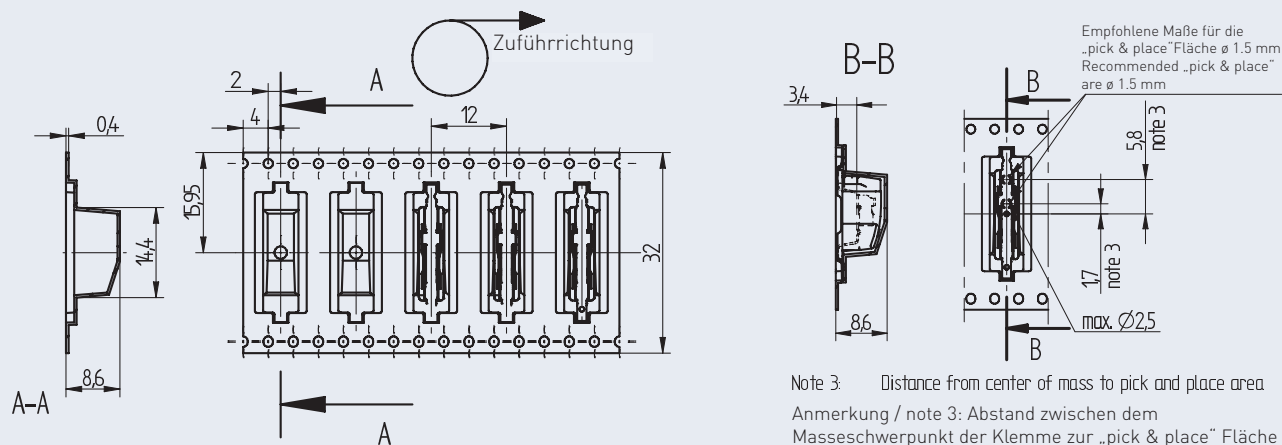


Richtung 1 Scherkraft längs	100 N
Richtung 2 Scherkraft längs	80 N
Richtung 3 Scherkraft quer	20 N
Richtung 4 Scherkraft quer	20 N
Richtung 5 Abzugskraft	20 N

Hinweise zur Verarbeitung

Geeignet für bleifreie Reflow-Lötprofile in Anlehnung an DIN EN 61760-1 bzw. DIN EN 60068-2-58 bis zu einer Peak-Temperatur von max. 260 °C. Aufgrund von unterschiedlichen anwendungsspezifischen Einflussgrößen (Bauteilanordnung und -ausrichtung, Lötanlage, Lötpaste) wird empfohlen, mittels Testläufen ein geeignetes Profil unter Fertigungsbedingungen zu ermitteln.

Abhängig vom SMD-Prozess und den Lötparametern kann eine leichte Verfärbung auftreten, welche jedoch die technische Funktionsweis nicht beeinflusst.



Lagerdauer	Lötbarkeit bei Lagerung zwischen -5°C und +40°C bei 10 - 60 %rH bis zu 6 Monaten. Bei Verarbeitung nach mehr als 6 Monaten sollte die Lötbarkeit gemäß J-STD-002D oder DIN EN 60068-2-58:2016 überprüft werden.
max. zulässige Reflowvorgänge	3
Lötprofil	Reflow-Profil (bleifreies Löten): The graph shows a reflow profile with the following parameters: - Heating rate: 1.5 - 2.5 K/s - Soak temperature: $T_s: 150\text{ °C} - 180\text{ °C}$ - Soak time: $t_s: 60 - 120\text{ sec}$ - Peak temperature: $T_{max} = 260\text{ °C}$ - Peak time: $t_{max} < 10\text{ sec}$ - Cooling rate: 2 - 3.5 K/s - Minimum temperature: $T_L \geq 230\text{ °C}$ - Minimum time: $t_L: 20 - 60\text{ sec}$
Lötbarkeit	Lötbarkeit der Bauteile ist durch Benetzungstest gemäß J-STD-002D geprüft
Montageverfahren	SMD, nach Zeichnung
Materialstärke SMD-Schablone	100 - 150 µm (Empfehlung BJB 150 µm)